

# Vivienda MODECOM MINI TREND AIR

Color:

Factor de forma: Mini Tower

Opciones de instalacin: vertical

Tipo de placa base mini-ITX

factor de forma de PSU: ATX (regular )

Carcasa

Dimensiones (AlxAxPr): 360x170x375 mm

Altura del enfriador, hasta: 140 mm

Material: acero

Patas de goma:

Parte interna

Fuente de alimentacin:

Ubicacin de la fuente de alimentacin: superior

Compartimentos 5 ,25 ": 1 pieza

Bahas internas 3,5": 1 ud

Compartimentos internos 2,5": 2 ud

orificios para ranuras de expansin: 4 piezas

Mecanismo de apertura: panel extrable

Refrigeracin y sopladoRanuras para ventiladores traseros: 1x80mm

Ranuras para ventiladores delanteros ventiladores: 1x120 mm

Ranuras de ventilador inferiores: 1x120 mm

Ranuras de ventilador: 3

Conectores y Funciones

Posicin: sobre el cuerpo

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2. generacin: 1 pieza

Audio (micrfono/auriculares):

Avanzado

Avanzado: Ventana de instalacin de CPU